

平成21年1月21日

各位

上場会社名 株式会社 日立ハイテクノロジーズ
 代表者 執行役社長 大林 秀仁
 (コード番号 8036)
 問合せ先責任者 社長室部長代理 加藤 弘之
 (TEL 03-3504-5138)

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成20年10月23日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

(金額の単位:百万円)

平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	880,000	35,000	35,300	22,000	159.95
今回発表予想(B)	760,000	17,000	18,300	9,100	66.16
増減額(B-A)	△120,000	△18,000	△17,000	△12,900	――
増減率(%)	△13.6	△51.4	△48.2	△58.6	――
(ご参考)前期実績 (平成20年3月期)	943,124	49,141	48,705	26,932	195.80

平成21年3月期通期個別業績予想数値の修正(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	686,000	24,200	30,300	21,820	158.63
今回発表予想(B)	602,000	10,850	17,900	13,100	95.24
増減額(B-A)	△84,000	△13,350	△12,400	△8,720	――
増減率(%)	△12.2	△55.2	△40.9	△40.0	――
(ご参考)前期実績 (平成20年3月期)	741,203	34,300	36,838	27,730	201.60

修正の理由

(1)平成21年3月期連結業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

米国発の金融危機に端を発した世界経済の急激な減速により、電子デバイスシステム事業においては、半導体メーカー及び液晶パネルメーカーの投資計画凍結や延期等により、半導体用評価・検査装置や液晶用モジュール組立設備等の売上が大幅に予想を下回る見込みです。また、ライフサイエンス事業においては、欧米市場向け医用分析装置が比較的堅調を維持していますが、情報エレクトロニクスや先端産業部材事業においては、顧客の発注延期や原油・素材価格の下落等により、チップマウンタや液晶関連部材等の売上が予想を下回る見込みです。

また、経営環境の悪化に対応するための事業構造改善費用等を特別損失に計上する予定であり、これらの結果、平成21年3月期連結業績は、売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益とも、前回発表の業績予想を下回る見込みとなりました。

以上のような状況に鑑み、上記の通り、平成21年3月期連結業績予想を修正します。

(2)平成21年3月期個別業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

平成20年7月25日に公表した平成21年3月期個別業績予想につきましても、連結と同様の理由により修正します。

(注)上記予想値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により異なる結果となることがあります。

以上